

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-010

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 活动类别       | <div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他 <u>线上会议</u></div>                                         |
| 参与单位名称     | 中信证券 博裕投资 华能贵诚信托 胤胜资产 国泰海通（以上排名不分先后）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 时间         | 2025 年 11 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 地点         | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 傅青炫<br>董事会秘书 金卫勤<br>证券事务代表 施翌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主要内容介绍     | <p>公司董事长向与会人员介绍了公司概况、发展布局、公司重大事项，董事长同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下：</p> <p><b>Q1、公司第三季度的经营情况能不能简单介绍一下？</b></p> <p>公司第三季度实现营收 2.912 亿元，同比增长 39.54%，实现归母净利润 8172 万元，同比增长 55.19%。公司自身的主营业务产品目前仍以电磁屏蔽材料及绝缘材料为主，整体表现较为稳定。此外，德佑新材于今年 9 月纳入公司合并报表，威斯双联于今年 8 月纳入公司合并报表。上述两家收购企业，增厚了公司整体的部分营收和利润。</p> <p><b>Q2、公司并购的两个标的的情况，未来对公司发展的推动有什么影响？</b></p> <p>两个并购标的与本公司隶属同一行业，具有显著的协同效应。通</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>过本次收购，未来将优化供应链管理，有效降低公司生产成本。</p> <p>其次，两个标的公司均具备深厚的技术积累和创新能力，其研发团队将显著增强公司自研体系的核心竞争力，进一步加强公司国产替代的能力。最后，客户端的差异性可以促进各自的产品互通，客户互融，进一步拓展现有客户群体。在通过本次收购可实现优势互补与资源协同，同时亦将保持业务端的独立运营体系，以并行发展模式释放协同价值，推动业绩提升。</p> <p><b>Q3、看到公司第三季度也有分红，公司在分红方面是如何考量的？</b></p> <p>公司整体经营稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将综合考虑未来盈利规模、现金流量状况等来确定公司的利润分配方案，积极与投资者分享企业的成长与发展成果。公司自 22 年上市以来始终坚持通过持续的现金分红回报投资者的信任。</p> <p><b>Q4、公司铜箔产品目前的进程和情况是什么样的？</b></p> <p>公司通过自有核心技术研发的 HVLP5 高频高速铜箔，具有极低的表面粗糙度且具备高剥离力的特点，未来可主要应用于 AI 服务器等需要高频高速低损耗的应用场景。公司已向中国（大陆及台湾地区）和日本的多头部覆铜板厂商（CCL 厂）送样，公司 HVLP5 的产品目前正在与下游客户验证推进中。目前，公司第一个细胞工厂已完成建设，设备陆续装机中。</p> |
| 附件清单（如有）             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 日期                   | 2025 年 11 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |